

# 材料・化学分野における将来の シミュレーション技術の展望

産応協では、産業界におけるスーパーコンピューティング技術（パソコンからスパコンまでを対象にした数値シミュレーション技術/HPC技術）の利活用促進を目的に、毎年技術セミナーを開催しております。このセミナーは、従来はスパコン・セミナーの名称で親しまれておりましたが、今年度よりセミナーテーマに幅を持たせるために産応協セミナーと改称いたしました。

2018年度第3回目である今回のセミナーは、「材料・化学分野における将来のシミュレーション技術の展望」をテーマにお届けいたします。産応協では、現在、産業シミュレーション・ロードマップを取り纏め、その公開準備を進めています。本セミナーでは、そのロードマップと関連の深い化学・材料分野での5テーマを取上げ、各有識者の方々に最先端シミュレーション技術から応用事例までご講演頂きます。ミクロからメソ領域の構造と物性の関係を明確化し、実材料の設計に繋げるためのシミュレーション技術の現状と今後の展望をまとめて聴く大変良い機会かと思えます。

ご多忙中とは存じますが、是非ご参加をご検討いただきますようご案内申し上げます。

2018年12月  
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会(産応協)/ICSCP

## プログラム

- 開催日時 : 2019年2月18日(月) 13:00~17:05 (開場: 12:30)
- 開催場所 : ワイム貸会議室四谷三丁目 (東京都新宿区四谷3-12丸正総本店ビル6階 裏面の地図をご参照下さい)
- プログラム : 講師・演題等は予告無く変更になることもございますので予めご了承下さい

13:00~13:05 開催の挨拶

13:05~13:50 複雑な凝集系化学反応の分子シミュレーション技術の現状と将来展望 (仮)  
名古屋大学大学院 情報学研究科 教授 長岡 正隆

13:50~14:35 ソフトマテリアルのシミュレーション技術の現状と将来展望 (仮)  
名古屋大学大学院 工学研究科物質科学専攻 教授 増淵 雄一

14:35~15:20 表面界面系の励起状態計算の現状と将来展望 (仮)  
東京大学 工学系研究科 化学システム工学専攻 教授 山下 晃一

15:20~15:30 休憩

15:30~16:15 有機半導体材料の大規模シミュレーションの現状と将来展望 (仮)  
鳥取大学大学院 工学研究科機械宇宙工学専攻 准教授 星 健夫

16:15~17:00 密度汎関数法の現状と将来展望 (仮)  
国立研究開発法人物質・材料研究機構 NIMS特別研究員 常田 貴夫

17:00~17:05 閉会の挨拶

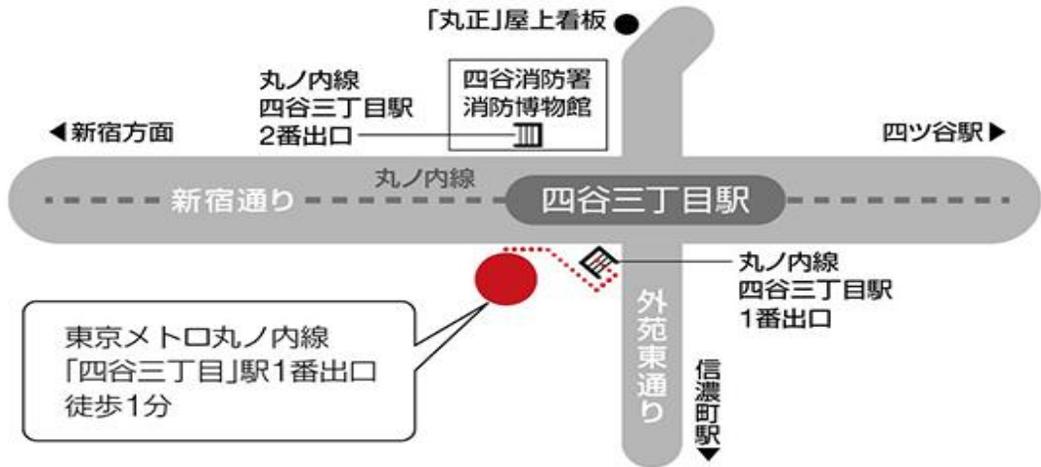
## セミナー会場

### ■会場

ワйм貸会議室四谷三丁目 東京都新宿区四谷3-1-2 丸正総本店ビル6F  
電話 0120-311-104  
<http://waim-group.co.jp/space/yotsuya/access.html>

### ■最寄り駅

○地下鉄  
東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 1番出口徒歩1分



丸ノ内線で新宿から4分 銀座から10分

## 募集要領

■定員：60名…先着順に受付、定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。

■参加費：20,000円／1名（税込）

2018年度第1回、第2回時に、一括申込みされている場合は、同一社内の方であれば何名様でもご参加頂けます。

なお産応協の正会員企業(団体)は、無料参加できますので事務局へ確認をお願いします。

■申し込み：参加ご希望の方は、E-mail または Fax で事務局まで以下をご連絡ください。  
[申込時連絡事項] ①氏名 ②会社・機関名、事業所住所 ③所属 ④E-mail ⑤電話番号  
申込みを確認次第、参加費の請求書をお送り致しますので下記口座にお振込み下さい。

みずほ銀行 虎ノ門支店(店番号 046) 普通預金口座 No.4175709  
「産応協 | ICSCP」(片仮名表記：サンオウキョウアイシーエスシーピー)

## お問い合わせ先

スーパーコンピューティング技術産業応用協議会(産応協/ICSCP)  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング西棟4階  
富士通虎ノ門オフィス内 事務局：中川、滝口  
URL： <http://www.icscp.jp/> E-mail： [icscp\\_office@icscp.jp](mailto:icscp_office@icscp.jp)  
TEL： 03-6435-5425 FAX： 03-6435-5426